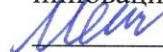


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе и
инновациям

 Мещеряков Р.В.

«___» 2017 г.



**ПРОГРАММА
Вступительного испытания по
специальной дисциплине**

по направлению подготовки

11.06.01 – ЭЛЕКТРОНИКА РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

профиль программы

05.27.02 – Вакуумная и плазменная электроника

Томск 2017

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируется на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.

Программа вступительного экзамена составлена на основании:

- федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1365;

- паспорта специальности научных работников 05.27.02 – вакуумная и плазменная электроника.

- программы-минимум кандидатского экзамена по специальности 05.27.02 – вакуумная и плазменная электроника, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274.

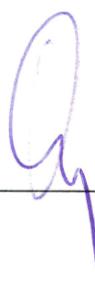
В основу программы положены следующие разделы вузовских дисциплин направлений подготовки магистратуры 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»:

- физические основы вакуумной техники
- эмиссионная электроника
- физика газового разряда и низкотемпературной плазмы;
- физика пучков заряженных частиц
- процессы электронно-ионно-плазменной обработки

Составитель программы:

Зав. кафедрой физики, профессор

Окс Е.М.



ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании кафедры физики
«_____» _____ 2017 г., протокол № _____.

СОГЛАСОВАНО:

Декан

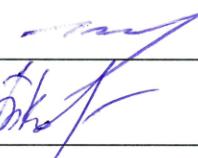
ФЭТ



Воронин А. И.

Зав. кафедрой

ЭП



Шандаров С.М.

Зав. аспирантурой и докторантурой



Коротина Т. Ю.

1. Общие положения

Программа вступительного испытания по специальности **05.27.02 – Вакуумная и плазменная электроника** предназначена для поступающих в аспирантуру в качестве руководящего учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к сдаче вступительного испытания.

Программа включает содержание профилирующих учебных дисциплин, входящих в основную образовательную программу высшего образования, по которой осуществляется подготовка студентов, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Целью программы вступительных испытаний является определение уровня знаний, готовности и возможности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к самостоятельному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности **05.27.02 – Вакуумная и плазменная электроника**.

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать высокий уровень практического и теоретического владения материалом вузовского курса.

2. Содержание программы

1. Кинетическая теория газов. Закон идеального газа. Число Авогадро. Скорость молекул. Закон распределения Максвелла—Больцмана. Свободный пробег молекул. Скорость испарения и давление пара. Теплопроводность газов при низких давлениях. Течение газов через трубы и отверстия.

2. Электрические явления в разреженных газах. Ионизация, возбуждение и рекомбинация газовых частиц. Эффективные сечения процессов. Движение заряженных частиц в газе.

3. Газовый разряд. Классификация типов газового разряда и отдельных его областей. Условия развития разряда. Кривые Пащенко. Высокочастотный разряд. Явления в вакуумных и плазменных приборах. Взаимодействие электронов с твердыми телами. Рентгеновское излучение. Глубина проникновения электронов в твёрдое тело. Прохождение электронов сквозь тонкую фольгу. Взаимодействие ионов с твердыми телами. Катодное распыление твердых тел, его закономерности.

4. Эмиссионная электроника. Термоэлектронная эмиссия. Распределение термоэлектронов по скоростям. Вторичная, фотоэлектронная, автоэлектронная и экзоэлектронная эмиссии. Формулы описывающие основные виды эмиссии. Эмиссия электронов под действием положительных ионов и нейтральных атомов. Эмиссия электронов из плазмы. Взрывная эмиссия.

5. Катоды: термоэлектронные, автоэлектронные (полевые), фотоэлектронные, вторично-эмиссионные. Динамическое равновесие в катодах. Стабильность эмиссии и срок службы главных конструктивно-технологических вариантов катодов. Подогреватели и процессы в них. Плазменные источники электронов. Плазменные источники ионов. Методы подавления термоэмиссии и вторичной электронной эмиссии.

6. Движение заряженных частиц в вакууме в электрических и магнитных полях. Движение при скорости, близкой к скорости света. Фокусирующее и расфокусирующее действие электростатических и магнитостатических полей.

7. Электродинамика. Уравнение Максвелла. Основные характеристики электромагнитного поля и среды.

8. Электровакуумные приборы (ЭВП). Приборы с электростатическим управлением. Токопрохождение в вакуумном промежутке. Плюсский диод. Распределение потенциала. Прохождение предварительно ускоренных электронов в плоском промежутке. Минимум потенциала и виртуальный катод.

9. Сеточное управление. Триоды, тетроды, клистроды. Частотные ограничения и пути их преодоления. Основные свойства и характеристики приборов с электростатическим управлением. Вакуумные вентили. Дугогасительные вакуумные камеры.

10. Плазменные приборы (ПЛП). Принцип действия, конструкция и характеристики плазменных приборов. Приборы тлеющего разряда. Плазменные панели постоянного тока. Панели переменного тока. Водородные тиаратроны. Игнитроны. Резонансные, сверхчастотные и искровые разрядники. Газовые лазеры и мазеры.

11. Устройства формирования и фокусировки интенсивных электронных потоков. Общие принципы формирования интенсивных электронных потоков. Электронно-оптические системы (ЭОС), СВЧ приборов О- и М-типа.

12. Магнитные и электростатические фокусирующие системы. Магнитная периодическая фокусирующая система (МПФС). Магнитная реверсивная фокусировка. Периодическая электростатическая (ПЭФ). Коллекторы. Коллекторы с рекуперацией.

13. Электронно-лучевые трубы (ЭЛТ) и фотоэлектронные приборы. Конструкция и характеристики электронно-лучевых приборов. Фокусирующие и отклоняющие системы ЭЛТ. Катодолюминесценция. Осциллографические трубы. Экраны осциллографических трубок. Запоминающие трубы. Функциональные трубы. Знаковые индикаторные трубы. Черно-белые и цветные кинескопы и дисплеи. Плазменные дисплеи, дисплеи с автокатодами. Передающие трубы. Электронно-оптические преобразователи. Основные типы фотодиодов. Фотоэлектронные умножители. Рентгеновские трубы.

14. Тугоплавкие металлы. Вольфрам, молибден, tantal и др. материалы и их сплавы. Рениевый эффект. Способы получения и очистки тугоплавких металлов и их сплавов. Зонная очистка тугоплавких металлов и сплавов. Их физические и химические свойства. Методы и приборы для контроля их качества. Применение тугоплавких металлов в вакуумной и плазменной электронике.

15. Благородные металлы. Платина, палладий, родий, осмий, золото, серебро и их сплавы. Применение благородных металлов и их сплавов в вакуумных и плазменных приборах.

16. Магнитные материалы. Магнитомягкие материалы. Ферриты. Кристаллические ферромагнетики.

17. Стекло. Состав, физико-химические свойства. Термическое расширение. Термостойкость. Электропроводность. Диэлектрические потери. Химическая устойчивость. Проницаемость для излучений. Газопроницаемость. Выбор стекла для различных условий применения. Обработка стекла. Ситаллы. Спай стекла с металлами, оборудование для производства стекла. Оборудование для спаев стекла с металлами. Приборы для контроля качества спаев.

18. Керамика и другие изоляционные материалы. Виды керамики и изоляционных материалов, используемых в вакуумной и плазменной электронике. Алмаз, нитриды, сапфир. Физико-химические свойства изоляционных материалов. Механические свойства. Термическое расширение. Теплопроводность. Удельное электрическое, объемное и поверхностное сопротивление. Диэлектрические свойства. Оптические свойства. Газопро-

ницаемость. Спай с металлами. Приборы для контроля физико-химических свойств. Оборудование и производство керамических деталей.

19. Газы. Инертные газы. Получение и физические свойства газов. Применение инертных газов в технологии ЭВП и ПЛП. Методы очистки инертных газов.

20. Активные газы. Водород, азот, кислород и углекислый газ. Физические и химические свойства активных газов. Методы очистки и приборы для контроля чистоты газов. Применение газов в технологии ЭВП и ПЛП.

21. Методы соединения деталей. Контактная сварка. Аргонодуговая сварка. Электронно-лучевая сварка. Сварка с использованием лазеров. Термокомпрессионная сварка. Оборудование, используемое для различного вида сварок. Пайка деталей припоями. Многоступенчатая пайка. Пайка в вакууме, в защитных и восстановительных средах. Оборудование для пайки. Печи периодического и непрерывного действия. Критерии паяемости и свариваемости деталей. Методы и приборы для контроля герметичности сварных и паянных швов. Заварка приборов со стеклянной оболочкой.

22. Откачка ЭВП и ПЛП. Газы, выделяемые из деталей в процессе откачки. Способы и режим обработки катодов и оболочек приборов. Контроль процесса откачки. Особенности откачки приборов в молекулярном режиме. Откачное оборудование. Автоматы и откачные посты. Обслуживание откачного оборудования. Способы очистки вакуумных систем. Вредные последствия длительного и высокотемпературного обезгаживания ЭВП при откачке. Особенности откачки ПЛП и способы наполнения их газами.

3. Порядок проведения вступительного экзамена.

Вступительные испытания проводятся в тестовой форме (20 вопросов по 5 баллов каждый). Продолжительность проведения письменного экзамена – не более 60 минут.

Уровень знаний поступающего оценивается по 100 балльной шкале. Минимальный балл, подтверждающий успешной прохождения вступительного испытания, равен 45.

Протокол приёма вступительного экзамена подписывается членами комиссии с указанием их ученой степени, учёного звания, занимаемой должности.

Протокол заседания экзаменационной комиссии после утверждения ректором (проректором по научной работе) ТУСУРа хранятся в отделе аспирантуры и докторантуре.

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику

При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

4. Образец экзаменационного билета для сдачи вступительного испытания

Вариант 0

1. При вхождении электрона в магнитное поле поперек силовых линий поля:

1. траектория движения не меняется
2. траектория движения циклоида
3. траектория движения гипербола

4. траектория движения прямая линия

2. Волновые свойства электрона проявляются, если его движение ограничено областью пространства, линейные размеры которого по отношению к длине волны Деброиля электрона

1. много меньше

2. соизмеримы

3. много больше

4. в точности равны

3. Для нахождения энергии уровня Ферми в металле необходимо знать:

1. концентрацию электронов в металле

2. работу выхода электронов из металла

3. среднюю энергию электронов в металле

4. валентность металла

4. С увеличением работы выхода электронов из металла плотность термоэлектронного тока:

1. линейно возрастает

2. увеличивается экспоненциально

3. уменьшается

4. не изменяется

5. Глубина проникновения первичных электронов в металл пропорциональна их энергии

1. в степени 1/2

2. в степени 3/2

3. в степени 2

4. в степени 1

6. Автоэлектронная эмиссия – это испускание электронов твердым телом под действием

1. электромагнитного излучения

2. нагревания

3. внешнего электрического поля

4. механической деформации

7. Основным условием существования объемного заряда в вакуумном диоде является

1. превышение тока эмиссии над анодным током

2. равенство тока эмиссии и анодного тока

3. превышение анодного тока над эмиссионным

4. бесконечная эмиссионная способность катода

7. На участке насыщения ВАХ вакуумного диода анодный ток

1. постоянен

2. растет из-за проявления эффекта Шоттки

3. растет из-за проявления туннельного эффекта

4. снижается в результате отражения электронов от виртуального катода.

8. Вторичная электронная эмиссия – это испускание электронов под действием

1. нагревания

2. электронной бомбардировки

3. внешнего электрического поля

4. электромагнитного излучения

9. При упругих столкновениях с атомами или молекулами газа электроны

1. теряют часть энергии пропорционально отношению масс

2. захватываются молекулами или атомами газа

3. приобретают часть энергии пропорционально отношению масс

4. отражаются без изменения энергии

10. Состояние вещества в виде низкотемпературной плазмы реализуется в

1. положительном столбе тлеющего разряда

2. катодных областях тлеющего и дугового разряда

- 3. искровом разряде
- 4. анодной области разряда

11. Зависимость сечения возбуждения атомов и молекул при электронном ударе от энергии электронов имеет вид

- 1. экспоненциально возрастающей кривой
- 2. кривой с максимумом
- 3. кривой с минимумом
- 4. экспоненциально падающей кривой

12. В условиях неравномерного распределения электрического поля в разрядном промежутке, когда радиус кривизны одного электрода существенно отличается от другого, наиболее вероятно возникновение разряда

- 1. тлеющего
- 2. высокочастотного
- 3. коронного
- 4. дугового

13. Прерывистый характер присущ разряду

- 1. дуговому
- 2. искровому
- 3. тлеющему
- 4. высокочастотному

14. Поддержание самостоятельного тлеющего разряда постоянного тока обеспечивается

- 1. термоэлектронной эмиссией
- 2. вторичной электрон-ионной эмиссией
- 3. фотоэлектронной эмиссией
- 4. автоэлектронной эмиссией

15. Для неравновесной газоразрядной плазмы низкого давления характерное соотношение энергии частиц газа (E_g), ионов (E_i) и электронов (E_e) имеет вид

- 1. $E_e = E_i = E_g$
- 2. $E_e \gg E_i > E_g$
- 3. $E_i > E_e > E_g$
- 4. $E_i < E_e < E_g$

16. Сверхвысокочастотные методы диагностики плазмы преимущественно применяются для исследования характеристик

- 1. дугового и высокочастотного разрядов высокого давления
- 2. искровых разрядов
- 3. тлеющего разряда низкого давления
- 4. тлеющего разряда высокого давления

17. Образование заряженных частиц в объеме самостоятельного тлеющего разряда происходит в основном за счет:

- 1. термической ионизации
- 2. ионизации при прямом электронном ударе
- 3. фотоионизации
- 4. ионизацией ионами

18. Зависимость потенциала зажигания разряда от давления (кривая Пашена) имеет вид:

- 1. монотонно растущей кривой
- 2. монотонно убывающей кривой
- 3. кривой с минимумом
- 4. кривой с максимумом

19. Закономерности развития какого разряда позволяет описать понятие стриммера

- 1. дугового
- 2. тлеющего
- 3. искрового

4. коронного

20. Зондовые методы исследования плазмы позволяют определить

1. среднюю энергию ионов
2. концентрацию атомов в возбужденном состоянии
3. температуру нейтральной компоненты плазмы
4. концентрацию плазмы

5.1. Основная литература

1. Грановский В.Л.. Электрический ток в газе. Установившийся ток. М., Наука, 1971.
2. Добрецов А.Н., Гомоюнова М.В., Эмиссионная электроника.- М: Наука, 1966.
3. Коваль Н.Н., Окс Е.М., Протасов Ю.С., Н.Н. Семашко. Эмиссионная электроника, Серия Электроника. Прикладная электроника. – Москва. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.
4. Окс Е.М. Источники электронов с плазменным катодом: физика, техника, применения. Томск, Издательство научно-технической литературы. 2005.
5. Райзер Ю.П.. Физика газового разряда. М., Наука, 1987.
6. Франк-Каменецкий А. Д. Лекции по физике плазмы. Москва, Атомиздат, 1964
7. Чен Ф. Введение в физику плазмы Москва, Мир, 1987.
8. Шимони К., Физическая электроника.- М: Энергия, 1977.

5.2. Дополнительная литература

1. Алямовский И.В. Электронные пучки и электронные пушки. М., “Советское радио”, 1966.
2. Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков Москва, Атомиздат, 1979
3. Батыгин В.Н. и др. Вакуумно-плотная керамика и ее спаи с металлами. М., “Энергия”, 1973.
4. Вакуумные дуги. Теория и приложения. Под редакцией Дж. Лафферти М., “Мир”, 1982.
5. Ворончев Т.А., Соболев В.Д. Физические основы электровакуумной техники. М., “Высшая школа”, 1967.
6. Гапонов А.В. и др. “Известия Вузов”, сер. Физика, том 2. №3 стр. 450-462, №5 стр. 836-874.
7. Жигарев А.А., Шамаева Г.Г. Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы, М., “Высшая школа”, 1982.
8. Киселёв А.Б. Металлооксидные катоды электронных приборов. М., МФТИ, 2001.
9. Королев Ю.Д., Месяц Г.А.. Физика импульсного пробоя газов, М., Наука, 1991
10. Крейндель Ю.Е. Плазменные источники электронов. М.: Атомиздат, 1977, 144 с.
11. Кудинцева Г.А. и др. Термоэлектронные катоды, М., “Энергия”, 1966.
12. Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Изд. 2-е, М., “Высшая школа”. Т.1, 1970, Т.П., 1972.
13. Лебединский М.А., Технология электровакуумного производства, М-Л., “Госэнергоиздат”, 1961.
14. Машиностроение. Энциклопедия, том III-8. Технологии, оборудование и системы управления в электронном машиностроении. М., “Машиностроение”, 2000.
15. Месяц Г.А., Эктоны в вакуумном разряде: пробой, искра, дуга.- М.: Наука , 2000.- 424 с.

16. Мик Д., Крэгс Д. Электрический пробой в газах. Пер. с англ. М., ИЛ, 1960.
17. Раховский В.И., Физические основы коммутации электрического тока в вакууме.- М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1970. - 536 с.
18. Ретер Г.. Электронные лавины и пробой в газах. Пер. с англ., М., "Мир", 1968.
19. Сливков Н.И., Процессы при высоком напряжении в вакууме.- М.: Энергоатомиздат, 1986.- 255 с.
20. Смирнов Б.М.. Введение в физику атомных столкновений. М., Атомиздат, 1973.
21. Смирнов Б.М.. Ионы и возбужденные атомы в плазме. М., Атомиздат, 1974.
22. Физика быстропротекающих процессов. Т.1, Под ред. Н.А. Златина, М., "Мир", 1971.
23. Царёв Б.М., Расчёт и конструирование электронных ламп, М., "Энергия", 1967.
24. Черепнин Н.В. Вакуумные свойства материалов для электронных приборов. М., "Советское радио", 1966.
25. Черепнин Н.В. Основы очистки, обезгаживания и откачки в вакуумной технике. М., "Советское радио", 1967
26. Эспе В. Технология электровакуумных материалов. М., Госэнергоиздат. Т.1, 1962, М., "Энергия", Т.2, 1968, Т.3, 1969.

5.3. Периодические издания

1. Журнал технической физики.
2. Письма в журнал технической физики.
3. Приборы и техника эксперимента.
4. Прикладная физика.
5. Известия высших учебных заведений. Физика
6. Общие вопросы физики и физического эксперимента

5.4. Перечень Интернет-ресурсов

1. Образовательный портал в свободном доступе: «Физика, химия, математика студентам и школьникам. Образовательный проект А.Н. Варгина» – Режим доступа: <http://www.ph4s.ru/>
2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
3. «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>
4. «Научно-образовательный портал ТУСУР» [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал университета. – Режим доступа: <http://edu.tusur.ru/>